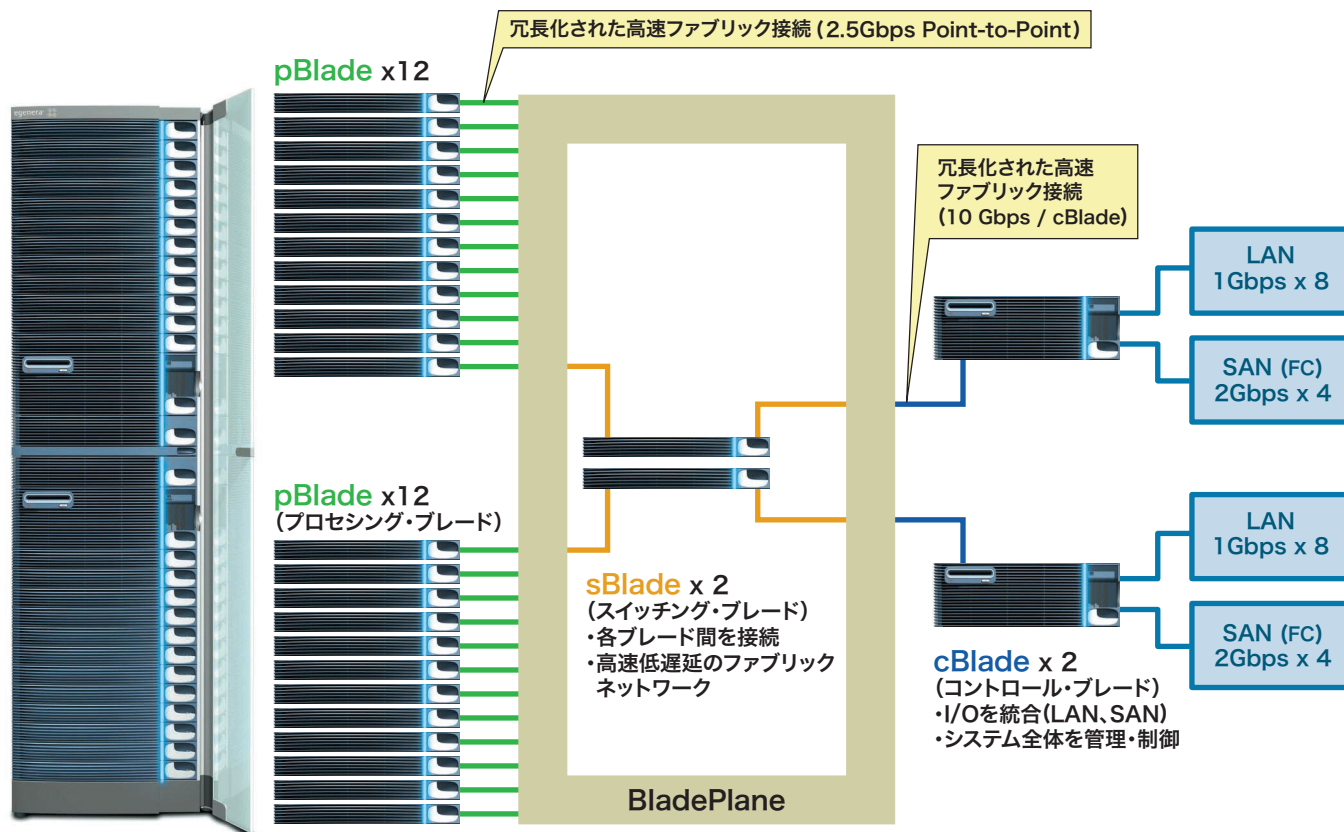


BladeFrame<sup>®</sup> EXは1筐体あたり24枚までのブレード(pBlade<sup>™</sup>)が搭載可能です。各pBladeにはハイエンドのIntel<sup>®</sup> XEON<sup>®</sup> プロセッサまたはAMD Opteron<sup>®</sup> プロセッサが搭載可能です。最大構成時(4ソケット、6コア、192GBバイトメモリ搭載の最上位pBladeを24枚搭載した場合)1筐体あたり576CPUコア、4,608GBメモリまでの拡張性を持ちます。

LAN、SANインタフェースを持つcBlade<sup>™</sup>と各pBladeは高速・低遅延のファブリックネットワークで接続され、システムの性能向上に寄与しています。



BladeFrame EXのアーキテクチャー

データセンター仮想化を実現するPANマネージャ<sup>®</sup>がシステム全体を管理・制御し、仮想LAN、仮想SAN上に置かれるプロセッシングリソース(CPU、メモリ)をビジネスニーズに合わせアプリケーションやサービスに動的に割り当てることが可能です。PANマネージャは複数のサーバのバックアップを1台のpBladeで行うことを可能とするN+1フェイルオーバー機能を標準で備え、LAN、SAN、マネジメントインタフェース、ファブリックネットワークも冗長化されているため、追加のコスト、労力なしで信頼性の高いシステムが構築できます。また、災害復旧(ディザスタリカバリー)機能も搭載可能で、高度な信頼性ニーズに応えます。電源系についても電源冗長化オプションを選択することが可能です。

# BladeFrame EX システムの仕様

外形寸法・重量	
高さ	208 cm
幅	61 cm
奥行	76 cm
重量最大	454 kg
その他	専用ラック

電源仕様	
入力電源コネクタ数	4 (PIM-R選択時は8)
入力電圧	200v / 208v / 230v
必要電源容量	1プラグ20 又は 30アンペア、単相AC
周波数	50 / 60 Hz (自動調整)
消費電力・冷却条件	構成に依存(弊社担当まで個別にお問合せください)

作動環境	
動作温度範囲	5°C~35°C
最大標高	1,828 m
動作湿度(結露なきこと)	10~80%
設置環境	コンピュータ室 / データセンタ相当の環境に対応

## 構成

cBlade (制御、I/Oユニット) x 2、sBlade (スイッチ・ファブリックユニット) x 2、  
pBlade (プロセッシング・ブレード) 最大24枚、ブレード・プレーン (バックプレーン)、  
筐体、PANマネージャ(仮想化管理ソフトウェア)、vBlade (ハイパーバイザー統合ソフトウェア、オプション)

## ブレード (pBlade) 仕様

CPU: Intel 及びAMD、2ソケット及び4ソケット、デュアルコア、クアッドコア及び6コア  
メモリ: 4~192GB

## 稼動可能OS

Red Hat® Enterprise Linux®, SUSE LINUX® Enterprise Server、  
Microsoft® Windows® Server 2003/2008 Enterprise Edition / Standard Edition、  
Sun® Solaris™ 10

## その他

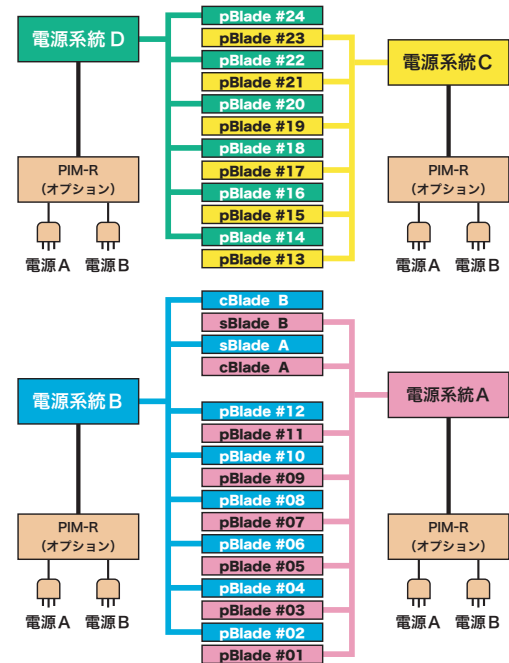
拡張仮想化機能BladeFarmsにより、複数筐体にまたがる仮想化をサポート (~3筐体、拡張予定)  
マネジメントインタフェースポート 10/100/1000Mbpsイーサネット(Copper) x 1 / cBlade  
コンソールポート RS232 x 1 / cBlade  
DVDドライブ x 1 / cBlade

## オプション

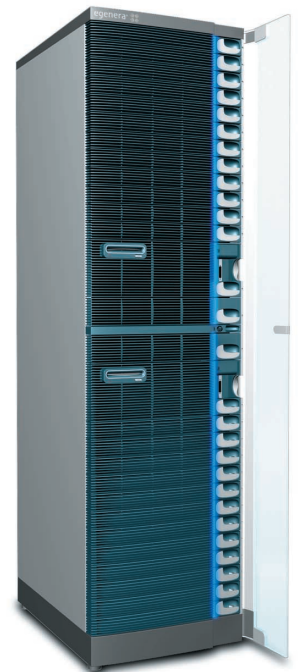
I/Oインタフェースオプション a. オプション1:HBA (2Gbps) x 4 / ギガビット・イーサネット (fiber) x 4 /  
10/100/1000Mbpsイーサネット (copper) x 4 (cBladeあたり)  
b. オプション2:HBA (2Gbps) x 4 / ギガビット・イーサネット(copper)x 4 /  
10/100/1000Mbpsイーサネット (copper) x 4 (cBladeあたり)

電源冗長化オプション (PIM-R) 選択可能  
電源容量オプション 1系統あたり16Aもしくは24A

電源冗長化オプション(PIM-R)選択時の電源系統図



- 4つの電源系統
- ・ 系統A/Bそれぞれ6つの pBlade と cBlade x 1、sBlade x 1 に電源供給。
  - ・ 系統C/Dそれぞれ6つの pBlade に電源供給。



Copyright © 2008, Egenera, Inc. All rights reserved. Egenera, Egeneraロゴ、およびBladeFrameは、米国Egenera, Inc. の登録商標または商標です。その他の記載されている会社名、製品名は各社の商標もしくは、登録商標です。本資料に記載されている情報は、予告なく変更になることがあります。



The  
Data Center  
Virtualization  
Company

## イージェネラ株式会社

〒163-0806 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル 6F  
TEL: 03-5321-7157 FAX: 03-5321-7158  
URL: <http://japan.egenera.com/>  
e-mail: [info-jp@egenera.com](mailto:info-jp@egenera.com)